

福建慧芯激光科技有限公司

招聘简章

福建慧芯激光科技有限公司成立于 2019 年，主要从事三五族化合物半导体等的研发、生产与销售。产品性能指标达到国际先进水平。产品市场前景广阔，公司具备强大的发展潜力。

- 1、工作时间：5 天制 8 小时
- 2、五险一金：入职后即可开始缴交
- 3、带薪假期：婚假、丧假、产假、病假、年休假，省外员工路程假和往返路费报销
- 4、津贴补贴：生日福利、过节费、免费自助午餐、筹建期住房补贴等
- 5、其他福利：免费年度体检，丰富多彩的员工团建活动
- 6、劳动报酬：提供行业内具有竞争力的薪资报酬和长期激励
- 7、职业发展：拥有广阔的横向和纵向学习空间和发展空间

联系人：Sunny

Tel：0595-87535577

邮箱：hr@intelasers.com

公司网址：www.intelasers.com



地址：泉州市惠安县世纪大道建筑业发展大厦 1 号楼 3 层

现因公司发展需要，诚聘以下岗位人才：

一、 研发工程师（2人）

岗位描述：

1. 负责光芯片（DFB/VcSEL/PD）的外延设计，结构设计，版图设计
2. 负责光芯片（DFB/VcSEL/PD）研发过程中关键工艺问题和技术问题的定位与解决
3. 负责光芯片（DFB/VcSEL/PD）测试计划及测试条件并对测试结果进行分析

任职要求：

1. 硕士及以上学历，半导体物理、激光、光电子等相关专业优先
2. 熟悉III-V族光芯片DFB/VCSEL/PD芯片的原理、设计、工艺流程
3. 能够熟练使用L-EDIT或类似软件设计光刻掩模板(mask)
4. 能够通过仿真软件对激光器进行光学特性,光电特性或热特性的仿真优先。
5. 熟悉光刻，薄膜，蚀刻，光学镀膜，解理等芯片工艺
6. 条理清楚，逻辑清晰，分析能力强，具有解决复杂问题的能力较强的执行能力
7. 具有良好的沟通协调能力，能承受一定的工作压力
8. 具备熟练的英语读写能力

二、 外延工程师（3人）

岗位描述：

1. 协助工程师完成设备安装，调试
2. 协助工程师完成设备日常维护，报告设备工作状态

3. 协助工程师完成工艺调试

任职要求：

1. 本科以上学历，光电、物理、机械机电、自动化等相关专业毕业，会 CAD, Matlab, Python 最佳
2. 具有较强的学习能力，具备钻研精神

三、 半导体工艺工程师（3人）

岗位描述：

1. 半导体芯片工艺流程日常维护
2. 新工艺研发以及流程控制、工艺流程的优化设计
3. 负责对工艺异常分析和处理以及良率改善和提升
4. 制定工艺技术文档，完成分析报告
5. 协助部门主管对本部门的工艺生产线的管理

任职要求：

1. 本科以上学历，半导体物理、材料、微电子、电子科学与技术及相关专业
2. 了解半导体工艺流程：如光刻、湿法刻蚀、干法刻蚀，电子蒸发，真空溅射，PECVD、RIE 等
3. 了解 SPC 管理手段分析协助工程师确保工艺和设备稳定性
4. 能熟练应用 Office 等办公软件，具有一定的写作能力，能熟练输出工作总结、汇报、案例等文档

四、 半导体设备工程师 (3 人)

岗位描述：

1. 新机台设备的安装调试工作
2. 做好责任区内的机台设备的异常处理以及维护保养工作
3. 负责对厂房设备工艺布局与二次配策划
4. 设备安全操作、安全知识的教育和培训工作，并编写设备 SOP 手册
5. 配合完成部门安排的其他事务

任职要求：

1. 本科以上学历，机械、电子、机电工程、自动化相关专业
2. 了解光刻，蒸镀，刻蚀，化学沉积，劈裂，测试分拣等工艺设备维护维修
3. 具有电工操作证、有 CAD 证书优先
4. 具备良好的英文读写能力及沟通能力

五、 光电芯片工艺整合工程师 (3 人)

岗位描述：

1. 负责半导体激光器产品 (DFB/EML/VCSEL/PD) 工艺流程研发和优化设计
2. 对协调后工艺的开发与控制-光刻，湿式蚀刻，等离子体蚀刻，金属和介电沉积系统，镀膜，注入和氧化熟悉
3. 对生产工艺异常分析处理和失效分析，改良优化工艺流程，提升良率，质量管控
4. 编制技术文件规范和标准，技术培训指导,制作作业指导书

任职要求：

1. 本科及以上学历，了解III/V族半导体 DFB/EML/VCSEL 和高速 PD 芯片的原理、设计、工艺流程
2. 具备半导体激光器基本知识,能够熟练使用 CAD 或类似软件设计光刻掩模板(mask)
3. 了解光刻、刻蚀、镀膜、溅射等各种光芯片工艺
4. 具备熟练的英语读写能力。

六、 光电芯片产品工程师 (3 人)

岗位描述：

1. 管理公司新型光电芯片产品的产品周期 ;负责某型号半导体激光器产品线，主抓产品升级、工艺提升等
2. 调查市场趋势和客户需求，协助公司 CTO 定义产品规格、器件结构、工艺流程、封装测试流程、内部和客户端验证流程，整理数据、撰写研发报告
3. 对产品的生产过程管理，整合公司内部资源以实现产品质量的持续改善、成品率提升

任职要求：

1. 本科以上学历，硕士优先，激光、光电子、半导体材料等相关光学专业
2. 熟悉半导体激光器的原理和应用；了解III/V族半导体 DFB/EML/VCSEL 和高速 PD 芯片的原理、设计、工艺流程
3. 了解半导体激光器、光纤激光器、固体激光器、光纤通信、激光应用行业、LED 行业具备设计、工艺、封装、测试、质量控制等相关技术背景

七、 可靠性工程师 (2 人)

岗位描述：

1. 负责制订产品可靠性测试方案，建立可靠性测试方法和标准，搭建并完善可靠性测试平台，解决产品各个阶段出现的可靠性问题
2. 实施可靠性监测，安排和执行可靠性试验，及时出具相关报告
3. 编制产品试验和验收大纲等可靠性相关文件，完成可靠性方面的评审和验证，研究产品可靠性及失效机理，提出改善方案，建立产品可靠性数据库

任职要求：

1. 本科及以上学历，电子、材料、化学、物理等相关专业
2. 了解可靠性测试标准和方法、实验设计和数据分析方法、常见的可靠性现象、失效机理和失效分析方法
3. 了解封装材料和封装结构的表征手段，会运用六西格玛质量管理程序
4. 了解芯片封装生产流程、典型产品结构和主要封装材料
5. 具有良好的问题分析与解决能力、团队沟通和协作能力